

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/019228

International filing date: 22 December 2004 (22.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-130940
Filing date: 27 April 2004 (27.04.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 04 February 2005 (04.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

13.1.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2004年 4月27日
Date of Application:

出願番号 特願2004-130940
Application Number:

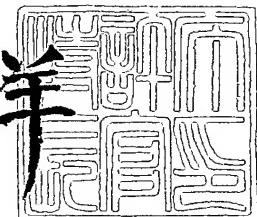
[ST. 10/C] : [JP2004-130940]

出願人 京セラ株式会社
Applicant(s):

2004年12月 1日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川 洋



出証番号 出証特2004-3109431

【書類名】 特許願
【整理番号】 0000350221
【提出日】 平成16年 4月27日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H05B 3/00
【発明者】
【住所又は居所】 鹿児島県国分市山下町1番1号 京セラ株式会社鹿児島国分工場
内
田中 智
【氏名】
【特許出願人】
【識別番号】 000006633
【住所又は居所】 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
【氏名又は名称】 京セラ株式会社
【代表者】 西口 泰夫
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 005337
【納付金額】 16,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

発熱抵抗体をセラミック基体内に内蔵してなるセラミックヒータにおいて、前記セラミック基体が少なくとも2種類の無機材料の積層構造からなることを特徴とするセラミックヒータ。

【請求項2】

前記発熱抵抗体が気密封止された封止部を有することを特徴とする請求項1記載のセラミックヒータ。

【請求項3】

前記発熱抵抗体に接している無機材料のうち少なくともひとつが、ガラスを主成分とするなどを特徴とする請求項1または2記載のセラミックヒータ。

【請求項4】

前記ガラスを主成分とする無機材料のボイド率を40%以下としたことを特徴とする請求項3に記載のセラミックヒータ。

【請求項5】

前記ガラスを主成分とする無機材料を平均1mm以下の厚みとしたことを特徴とする請求項3に記載のセラミックヒータ

【請求項6】

前記無機材料のそれぞれの熱膨張係数の差を $1 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ 以下としたことを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載のセラミックヒータ。

【請求項7】

前記セラミック基体が少なくとも3層以上の積層構造からなることを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載のセラミックヒータ。

【請求項8】

前記無機材料の少なくともひとつが、主にアルミナまたは窒化珪素からなることを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載のセラミックヒータ。

【請求項9】

前記発熱抵抗体が、主に6a族金属または6a族化合物からなることを特徴とする請求項1乃至8のいずれかに記載のセラミックヒータ。

【請求項10】

請求項1乃至9に記載のセラミックヒータを用いたことを特徴とするヘアゴテ。

【請求項11】

セラミック基体上に塗布したガラスを一旦溶解し、脱気をしてから別のセラミック基体を重ねて封止することを特徴とするセラミックヒータの製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】セラミックヒータおよびその製造方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、自動車用の空燃比検知センサ加熱用ヒータや気化器用ヒータ、半田ごて用ヒータなどに使用するセラミックヒータに関するものである。

【背景技術】

【0002】

従来より、アルミナを主成分とするセラミックス中に、W、Re、Mo等の高融点金属からなる発熱抵抗体を埋設してなるアルミナセラミックヒータが、一般的に用いられている。

【0003】

例えば、円柱状のセラミックヒータを製造する場合は、図6に示すようにセラミックロッド32とセラミックシート33を用意し、セラミックシート33の一方面にW、Re、Mo等の高融点金属のペーストを印刷して発熱抵抗体4とリード引出部5を形成した後、これらを形成した面が内側となるようにセラミックシート33を上記セラミックロッド32の周囲に巻付け、全体を焼成一体化することによりセラミックヒータ31を得ることができる。

【0004】

この時、セラミックシート33上には、発熱抵抗体4に直接リード引出部35が接続され、該リード引出部35の末端にスルーホール6が形成され裏面の電極パッド37と該リード引出部35がスルーホール36で接続され、スルーホール36には、必要に応じて導体ペーストが注入される。

【0005】

このようにして従来のセラミックヒータ31は、発熱抵抗体33をセラミックス部分と同時焼成することにより形成するようになっていた。

【特許文献1】特開2001-126852号

【特許文献2】特開2002-146465号

【特許文献3】特開平07-37681号

【特許文献4】特開平06-283257号

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

しかしながら、このようなセラミックヒータは、発熱抵抗体をセラミック基体内部に形成するため、抵抗値の調整が難しく、抵抗ばらつきを小さくすることが難しかった。

【0007】

これに対し、発熱抵抗体をセラミック基体の表面に形成すれば、発熱抵抗体の抵抗値をトリミング等の手法で調整することが可能であったが、発熱抵抗体を表面に露出させると、耐久性が低下した。

【0008】

また、発熱抵抗体の表面に封止部を形成して耐久性を調整しようとすると、封止部にクラックが発生して、耐久性良好なセラミックヒータを得ることができないという問題があった。

【課題を解決するための手段】

【0009】

上記に鑑みて本発明のセラミックヒータは発熱抵抗体をセラミック基体内に内蔵してなるセラミックヒータにおいて、前記セラミック基体が少なくとも2種類の無機材料の積層構造からなることを特徴とするものである。

【0010】

また、前記発熱抵抗体が気密封止された封止部を有することを特徴とするものである。

【0011】

また、前記発熱抵抗体に接している無機材料のうち少なくともひとつが、ガラスを主成分とすることを特徴とするものである。

【0012】

また、前記ガラスを主成分とする無機材料のボイド率を40%以下としたことを特徴とするものである。

【0013】

また、前記ガラスを主成分とする無機材料を平均1mm以下の厚みとしたことを特徴とするものである。

【0014】

また、前記無機材料のそれぞれの熱膨張係数の差を $1 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ 以下としたことを特徴とするものである。

【0015】

また、前記セラミック基体が少なくとも3層以上の積層構造からなることを特徴とするものである。

【0016】

また、前記無機材料の少なくともひとつが、主にアルミナまたは窒化珪素からなることを特徴とするものである。

【0017】

また、前記発熱抵抗体が、主に6a族金属または6a族化合物からなることを特徴とするものである。

【0018】

さらに、セラミック基体上に塗布したガラスを一旦溶解し、脱気をしてから別のセラミック基体を重ねて封止することを特徴とするものである。

【発明の効果】**【0019】**

本発明によれば、セラミック基体の表面に高融点金属粉末を含有する発熱抵抗体を焼き付けした後、該発熱抵抗体の上に別のセラミック基体を重ねて封止することにより、セラミックヒータの発熱抵抗体を焼き付けた後で抵抗値調整した後セラミックヒータを加工することができるようになると同時に、耐久性良好なセラミックヒータを提供できるようになる。

【発明を実施するための最良の形態】**【0020】**

以下本発明のセラミックヒータの実施形態を、図1を用いて説明する。

【0021】

(a)は、本発明のセラミックヒータ1の一実施例を示す斜視図であり、(b)は、そのX-X断面図である。

【0022】

また、図2は、発熱抵抗体の一例を示す図である。

【0023】

このセラミックヒータ1は、2つのセラミック基体2とこれらを接合する封止部10という2つの無機材料からなるセラミック基材5と、該セラミック基材5に内蔵される発熱抵抗体3により構成されている。セラミック基体2と、該セラミック基体2の表面に形成された発熱抵抗体3およびリード引出部4と、その後該発熱抵抗体3およびリード引出部4の上に形成された封止部10とを有している。セラミック基体2aには切り欠き12が4の上に形成された封止部10とを有している。セラミック基体2aには切り欠き12が形成され、該切り欠き12にリード引出部4の一部が露出し、該リード引出部4にリード部材9がロウ材により固定されている。

【0024】

このセラミックヒータ1は、セラミック基体2aの表面に、高融点金属およびガラスを含有するペーストを塗布した後焼き付け処理することにより発熱抵抗体3およびリード引

出部4を形成し、さらにその上に封止部10となるガラスペーストを塗布し、その上に別のセラミック基体2bを重ねて熱処理することにより全体を一体化する。

【0025】

また、図2に示したような発熱抵抗体3に対して、抵抗値を測定し、必要に応じて発熱抵抗体をトリミングして、抵抗値を所望の範囲に抵抗調整することができる。

【0026】

このようにすることにより、ひとつの無機材料からなるセラミック基材中に発熱抵抗体を内蔵した図6に示すような従来のセラミックヒータ31に較べて、抵抗値を精密に制御することが可能となる。

【0027】

前記封止部10のガラスとしては、該ガラスのガラス転移点以下の温度における熱膨張率と基体のセラミック基体2との熱膨張率の差を $1 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ の範囲内とすることが好ましい。ガラスの熱膨張率がこの範囲を越えると、使用中に封止部10に発生する応力が大きくなり、封止部10にクラックが発生し易くなる。好ましくは前記熱膨張率の差が $0.5 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ 以内、さらに好ましくは $0.2 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ 以内、理想的には $0.1 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ 以内であることが良い。

【0028】

また、前記封止部10に形成するボイド率を40%以下にすることが好ましい。このボイド率が40%を越えると使用中の熱サイクルにより封止部10にクラックが発生し、セラミックヒータ1の耐久性が低下するので好ましくない。封止部10とその上に重ねるセラミック基体2の平坦度のずれにより接合時に、ボイド11が生成しやすくなる。

【0029】

さらに好ましくは、ボイド率を30%以下にする方が良い。

【0030】

このボイド率は、図3に示すようにセラミックヒータ1の断面を研磨し、その表面に露出した封止部10の面積Sgに対するボイド11部分の面積Sbの比率を計算することにより求めることができる。面積Sg、Sbの測定については、電子顕微鏡写真(SEM)による像を画像解析することにより簡便に測定することも可能である。

【0031】

また、前記封止部10の平均厚みは1mm以下とすることが好ましい。前記封止部10の厚みが1mmを越えると、セラミックヒータ1を急速昇温させた場合に、封止部10にクラックが発生するので好ましくない。

【0032】

また、封止部10の厚みが $5 \mu\text{m}$ 未満では、発熱抵抗体3の周囲に形成される段差をガラスが充分埋めることができず、ボイド11が多発して、セラミックヒータ1の耐久性が低下する場合がある。

【0033】

また、この封止部10の形成においては、セラミック基体上に塗布したガラスを一旦溶解し、脱気をしてから別のセラミック基体2bを重ねて封止すれば、封止部10に発生するボイド11の生成を抑制することができる。

【0034】

また、セラミック基体2の材質としては、アルミナ、ムライト等の酸化物セラミックスとすることが好ましいが、窒化珪素、窒化アルミニウム、炭化珪素等の非酸化物セラミックスを用いても構わない。非酸化物セラミックスを用いる場合は、酸化雰囲気中で熱処理し、セラミック基体2の表面に酸化層を形成すると発熱抵抗体3、リード引出部4や封止部10との濡れが良くなり、セラミックヒータ1の耐久性が向上する。

【0035】

また、セラミック基体2a、2bの表面の平坦度は、 $200 \mu\text{m}$ 以下とする事が好ましい。さらに好ましくは、 $100 \mu\text{m}$ 以下、理想的には $30 \mu\text{m}$ 以下とすることがよい。これが $200 \mu\text{m}$ を越えると、封止部10に図3に示すようなボイド11が発生しやすくな

り、セラミックヒータ1の耐久性が低下するので好ましくない。

[0036]

【0036】
また、酸化物セラミックスの場合、焼結した表面をそのまま使用する方が、焼成時に表面にセラミックス中のガラスが浮き出していくので、発熱抵抗体3やリード引出部4を形成しやすくなる。

(0037)

【0037】 また、発熱抵抗体3に用いる材料としては、W、Mo、Reの単体もしくはこれらの合金、もしくはTiN、WC等の金属珪化物、金属炭化物などを使用することも可能である。発熱抵抗体3の材料として、これらのような高融点の素材を用いると、使用中に金属の焼結が進むようなことがないので、耐久性が向上する。

[0038]

また、図4はリード部材9のロウ付け部の一例を示す拡大図である。

[00391]

図4に示すように電極パッド4の周辺部をセラミック基体2の間に挟み込むようにすれば、電極パッド4の接合強度を向上させることができる。電極パッド4の表面には、一次メッキ層7aを形成する。これによりリード部材9のロウ付けの際のロウ材8の流れ性良好にすることが可能となる。この時、リード部材9を固定するロウ材8のロウ付け温度を1000℃以下に設定すれば、ロウ付け後の残留応力を低減できるので良い。

[0 0 4 0]

【0040】 また、湿度が高い雰囲気中でセラミックヒータ1を使用する場合、Au系、Cu系のロウ材を用いた方が、マイグレーションが発生し難くなるので好ましい。ロウ材8としては、Au-Au-Cu-Au-Ni、Ag-Ag-Cu系の物が使用される。Au-Cuロウとしては、Au含有量が25~95重量%としAu-Niロウとしては、Au含有量が50~95重量%の成分量の物が使われる。Ag-Cuロウとしては、Ag含有量が60~90重量%、さらに好ましくは70~75重量%とすると、共晶点の組成となりをロウ付け時の昇温、降温時の異種組成の合金の生成を防止出来るために、ロウ付け後の残留応力を低減できるので良い。

[0 0 4 1]

また、湿度が高い雰囲気中で使用する場合、Au系、Cu系のロウ材8を用いた方が、マイグレーションが発生しにくくなるので好ましい。

[0 0 4 2]

また、ロウ材8の表面には、高温耐久性向上及び腐食からロウ材8を保護するために通常Niからなる2次メッキ層7bを形成することが好ましい。

[0 0 4 3]

また、耐久性向上のためには、2次メッキ層7bを構成する結晶の粒径を5μm以下に小さくするために高温放置環境下ではクラックの発生が確認される。

[0 0 4 4]

また、理由は定かでないが2次メッキ層7bをなす結晶の粒径が小さい方がメッキの詰まりも良いためにミクロ的な欠陥を防止出来る物と考えられる。この2次メッキ層7bは硼素系の無電解Niメッキを用いた。

[0 0 4 5]

[0046]

【0040】 次にリード部材9の材質としては、耐熱性良好なNi系やFe-Ni系合金等を使用する
ことが好ましい。発熱抵抗体4からの熱伝達により、使用中にリード部材9の温度が上
昇し、劣化する可能性があるからである。

【0047】

中でも、リード部材9の材質としてNiやFe-Ni合金を使用する場合、その平均結晶粒径を400μm以下とすることが好ましい。前記平均粒径が400μmを越えると、使用時の振動および熱サイクルにより、ロウ付け部近傍のリード部材9が疲労し、クラックが発生するので好ましくない。他の材質についても、例えばリード部材9の粒径がリード部材9の厚みより大きくなると、ロウ材8とリード部材9の境界付近の粒界に応力が集中して、クラックが発生するので好ましくない。

【0048】

なお、ロウ付けの際の熱処理は、試料間のバラツキを小さくするためには、ロウ材8の融点より十分余裕をとった高めの温度で熱処理する必要があるが、リード部材9の平均結晶粒径を400μm以下と小さくするためには、ロウ付けの際の温度をできるだけ下げ、処理時間を短くすればよい。

【0049】

また、セラミックヒータ1の材質としてアルミナを用いる場合は、Al₂O₃ 88~95重量%、SiO₂ 2~7重量%、CaO 0.5~3重量%、MgO 0.5~3重量%、ZrO₂ 1~3重量%からなるアルミナを使用することが好ましい。ここで、セラミックスとしてアルミナの例を示したが、本発明で示したことは、アルミナ質セラミックスに限らずされことではなく、窒化珪素質セラミックス、窒化アルミニウム質セラミックス、炭化珪素質セラミックス等、また、セラミックヒータ1のみならず、Au系のロウ付けを実施する全てのものに当てはまる現象である。

【0050】

また、図5は、本発明のセラミックヒータ1を用いたヘアアイロンの一例を示す斜視図である。このヘアアイロンは、先端のアーム22の間に髪毛を挿入し、取手21を掴むことにより、髪毛を加熱しながら加圧して髪毛を加工する。アーム22の内部には、セラミックヒータ26が挿入されており、髪毛と直接触れる部分には、ステンレス等の金属板23が設置されている。

【0051】

また、アーム22の外側には火傷防止のために耐熱プラスチック製のカバーを装着した構造となっている。

【実施例】**【0052】****実施例1**

Al₂O₃を主成分とし、SiO₂、CaO、MgO、ZrO₂を合計10重量%以内になるように調整したセラミックシートを準備し、所定の寸法になるように切断およびスナップ加工した後、1600℃の酸化雰囲気中でセラミック基体2を焼成した。この表面に、Wとガラスを混合したペーストからなる発熱抵抗体3とリード引出部4をプリントし、1200℃の還元雰囲気中で焼き付けた。

【0053】

その後、発熱抵抗体をレーザートリミングにより抵抗が中心値10Ωに対し0.1Ω以内に入るように加工した。そして、スナップラインに沿ってセラミック基体2を各々分割した。

【0054】

その後さらに、発熱抵抗体3およびリード引出部4の上に封止部10となるガラスペーストを塗布し、1200℃の還元雰囲気中で再度熱処理し、封止部10中のボイド11を除去した後、別のセラミック基体2を重ねて1200℃で熱処理し、セラミック基体2同士を封止部10により一体化して、幅10mm、厚み1.6mm、長さ100mmのセラミックヒータ1を得た。

【0055】

比較例として、Al₂O₃を主成分とし、SiO₂、CaO、MgO、ZrO₂を合計10重量%以内になるように調整したセラミックグリーンシート3を準備し、この表面に

、W-R eからなる発熱抵抗体4とWからなるリード引出部5をプリントした。

【0056】

また、裏面には電極パッド7をプリントした。発熱抵抗体4は、抵抗値 10Ω となるように発熱長さ5mmで4往復のパターンとなるように作製した。

【0057】

そして、Wからなるリード引出部35の末端には、スルーホール36を形成し、ここにペーストを注入する事により電極パッド37とリード引出部35間の導通をとった。スルーホール36の位置は、ロウ付けを実施した場合にロウ付け部38の内側に入るように形成した。こうして準備したセラミックグリーンシート33をセラミックロッド32の周囲に密着し、 $1500\sim1600^\circ\text{C}$ で焼成することにより、セラミックヒータ31とした。

【0058】

このようにして作製したセラミックヒータ1、31の抵抗値を各100個測定し、ばらつきを比較した。

【0059】

また、 $800^\circ\text{C}\times1000$ 時間の連続通電耐久試験を実施した。

【0060】

結果を表1に示した。

【表1】

	抵抗ばらつき (%)	σ	耐久抵抗 変化率 (%)
本発明	± 1	0.077	1.2
比較例	± 3.5	0.29	1.1

【0061】

表1から判るように、本発明のセラミックヒータ1は、抵抗値ばらつきが $\pm 1\%$ 以内、 σ が 0.077Ω となったのに対し、比較例の従来のセラミックヒータ31は、抵抗値ばらつきが $\pm 3.5\%$ 、 σ が 0.58Ω となり、本発明のセラミックヒータ1は、抵抗値ばらつきを小さくすることができる事が判った。

【0062】

また、 800°C 連続通電耐久試験は、抵抗変化が1%以下で、両者とも良好な耐久性を示した。

【0063】

実施例2

ここでは、封止部10のボイド率と耐久性の関係を調べた。

【0064】

Al_2O_3 を主成分とし、 SiO_2 、 CaO 、 MgO 、 ZrO_2 を合計10重量%以内になるように調整したセラミックシートを準備し、所定の寸法になるように切断およびスナップ加工した後、 1600°C の酸化雰囲気中でセラミック基体2を焼成した。この表面にWとガラスを混合したペーストからなる発熱抵抗体3とリード引出部4をプリントし、Wとガラスを混合したペーストからなる発熱抵抗体3とリード引出部4をプリントし、 1200°C の還元雰囲気中で焼き付けた。そして、スナップラインに沿ってセラミック基体2を各々分割した。

【0065】

その後さらに、発熱抵抗体3およびリード引出部4の上に封止部10となるガラスペーストを塗布し、1200℃の還元雰囲気中で再度熱処理し、封止部10中のボイド11を除去した後、別のセラミック基体2を重ねて1200℃で熱処理し、セラミック基体2同士を封止部10により一体化して、幅10mm、厚み1.6mm、長さ100mmのセラミックヒータ1を得た。

【0066】

この時、封止部10とこれに重ねるセラミック基体2の平坦度を調整し、また、接合前に調整する封止部10のボイド抜きのための熱処理条件を調整し、各ロット15本のサンプルを作製し、各ロット3本について、封止部10のボイド率を測定し、各ロット10本を700℃まで加熱し、700℃から40℃以下への冷却速度を60秒以下とする冷却試験を100サイクル実施し、封止部10へのクラックの発生の有無を調べた。

【0067】

これらの結果を、表2に示した。

【表2】

No.	ボイド率 (%)	クラック 発生数
1	3	0
2	12	0
3	19	0
4	25	0
5	30	0
6	40	1
7	48	6

【0068】

表2から判るように、ボイド率が40%以下であるNo. 1~6は、クラックの発生数が1個以下で良好な耐久性を示した。さらに、ボイド率が30%以下のNo. 1~5は、クラックの発生はゼロであった。

【0069】

実施例3

Al_2O_3 を主成分とし、 SiO_2 、 CaO 、 MgO 、 ZrO_2 を合計10重量%以内になるように調整したセラミックシートを準備し、所定の寸法になるように切断およびスナップ加工した後、1600℃の酸化雰囲気中でセラミック基体2を焼成した。この表面に、Wとガラスを混合したペーストからなる発熱抵抗体3とリード引出部4をプリントし、1200℃の還元雰囲気中で焼き付けた。そして、スナップラインに沿ってセラミック基体2を各々分割した。

【0070】

その後さらに、発熱抵抗体3およびリード引出部4の上に封止部10となるガラスペーストを塗布し、1200℃の還元雰囲気中で再度熱処理し、封止部10中のボイド11を除去した後、別のセラミック基体2を重ねて1200℃で熱処理し、セラミック基体2同士を封止部10により一体化して、幅10mm、厚み1.6mm、長さ100mmのセラミックヒータ1を得た。

【0071】

この時、前記封止部10に用いるガラスの熱膨張率を、40~500℃のアルミナの熱膨張率 $7.3 \times 10^{-7} / \text{°C}$ に対し、これらの差が $0.05 \sim 1.2 \times 10^{-5} / \text{°C}$ となるように変更したガラスを用いて各ロット20本のサンプルを準備した。

【0072】

このようにして得たセラミックヒータ1を、700℃まで45秒で昇温させ、2分間の空冷により40℃以下に冷却するサイクルを3000サイクル施し、封止部10へのクラックの発生の有無を調べた。

【0073】

結果を、表3に示した。

【表3】

No.	セラミック基材と ガラスの熱膨張率 差 × 10 ⁻⁵ / °C	耐久試験後 クラックの 発生数
1*	1.2	20
2	1.0	6
3	0.5	3
4	0.2	1
5	0.1	0
6	0.05	0

*は、本発明の請求範囲外である。

【0074】

表3から判るように、封止部10に使用するガラスの熱膨張率とアルミナからなるセラミック基体2の熱膨張率の差が $1.2 \times 10^{-5} / \text{°C}$ であったNo. 1には、100サイクル程度で全数封止部10にクラックが発生した。これに対し前記熱膨張率の差を $1.0 \times 10^{-5} / \text{°C}$ としたNo. 2～6はクラックの発生数が6個以下で、良好な耐久性を示した。前記熱膨張率の差を $0.1 \times 10^{-5} / \text{°C}$ 以下としたNo. 5, 6は、クラックが全く発生しなかった。前記熱膨張率の差を $0.2 \times 10^{-5} / \text{°C}$ としたNo. 4は1個クラックが発生し、前記熱膨張率の差を $0.5 \times 10^{-5} / \text{°C}$ としたNo. 3は、クラックが3個発生した。

【0075】

実施例4

ここでは、封止部10の厚みを調整して、冷却の熱衝撃に対する影響を調査した。ボイド率については、20～22%に調整した。

【0076】

封止部10のガラスの平均厚みを、ガラスのプリント回数の調整により3～1200μmとなるように調整してサンプルを各ロット15個筒作製した。封止部10の厚みが300μm以上のものについては、セラミック基体2の表面に厚み調整用の突起を各3点準備し、それぞれ封止部10の厚みが所望の厚みとなるように調整した。

【0077】

これら結果を、表3に示した。

【表4】

No.	封止部の厚み (μm)	クラックの 発生数
1	3	—
2	5	0
3	20	0
4	120	0
5	300	0
6	500	0
7	1000	1
8	1200	10

【0078】

表4から判るように、封止部10の厚みを $1200\mu\text{m}$ としたNo. 8には、全数クラックが発生した。

【0079】

また、封止部10の厚みを $3\mu\text{m}$ としたNo. 1は、ボイドが40%を越えてしまったので、評価しなかった。

【0080】

これに対し、封止部10の厚みを5~1000としたNo. 2~7は、クラックの発生数が1本以下で良好な特性を示した。

【0081】

さらに、封止部10の厚みを5~500 μm にしたNo. 2~6は、全くクラックが発生しなかった。

【図面の簡単な説明】

【0082】

【図1】(a)は本発明のセラミックヒータの一実施形態を示す斜視図、(b)はそのX-X断面図である。

【図2】本発明のセラミックヒータにおける発熱抵抗体を示す図である。

【図3】本発明のセラミックヒータの封止部の断面図である。

【図4】本発明のセラミックヒータのロウ付け部の断面図である。

【図5】本発明のセラミックヒータを用いたヘアアイロンの一例を示す斜視図である。

【図6】(a)は、従来のセラミックヒータの斜視図であり、(b)はその展開斜視図である。

【符号の説明】

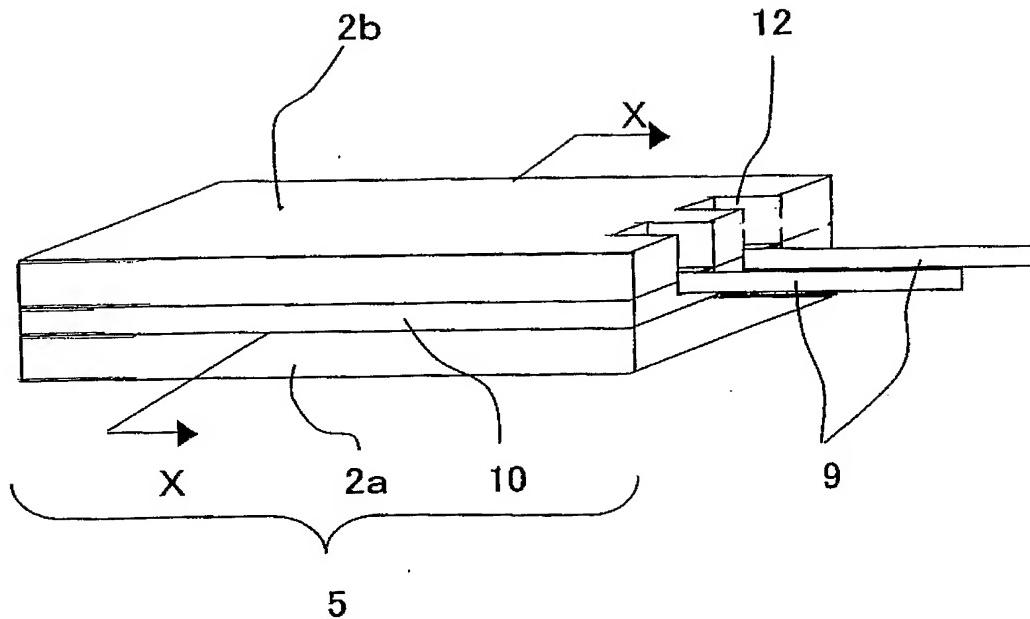
【0083】

- 1 : セラミックヒータ
- 2 : セラミック基体
- 3 : 発熱抵抗体
- 4 : リード引出部
- 7 : メッキ
- 8 : ロウ材
- 9 : リード部材
- 10 : 封止部
- 11 : ボイド

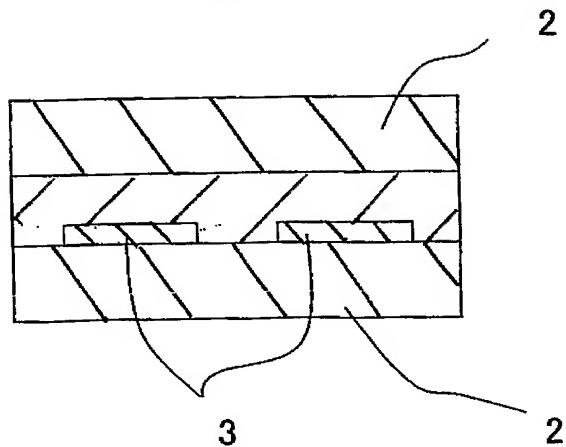
12：切り欠き

【書類名】 図面
【図1】

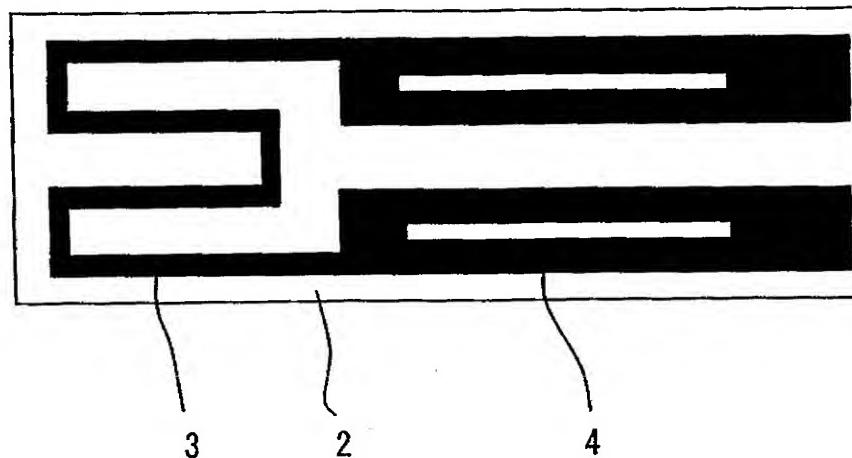
(a)



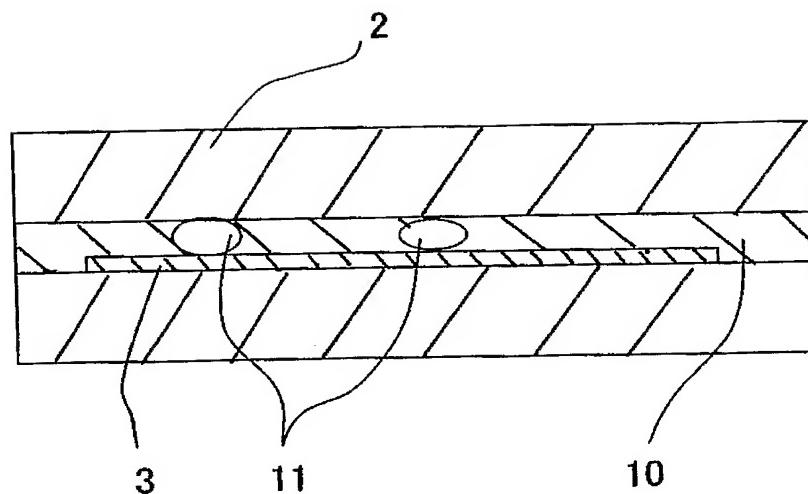
(b)



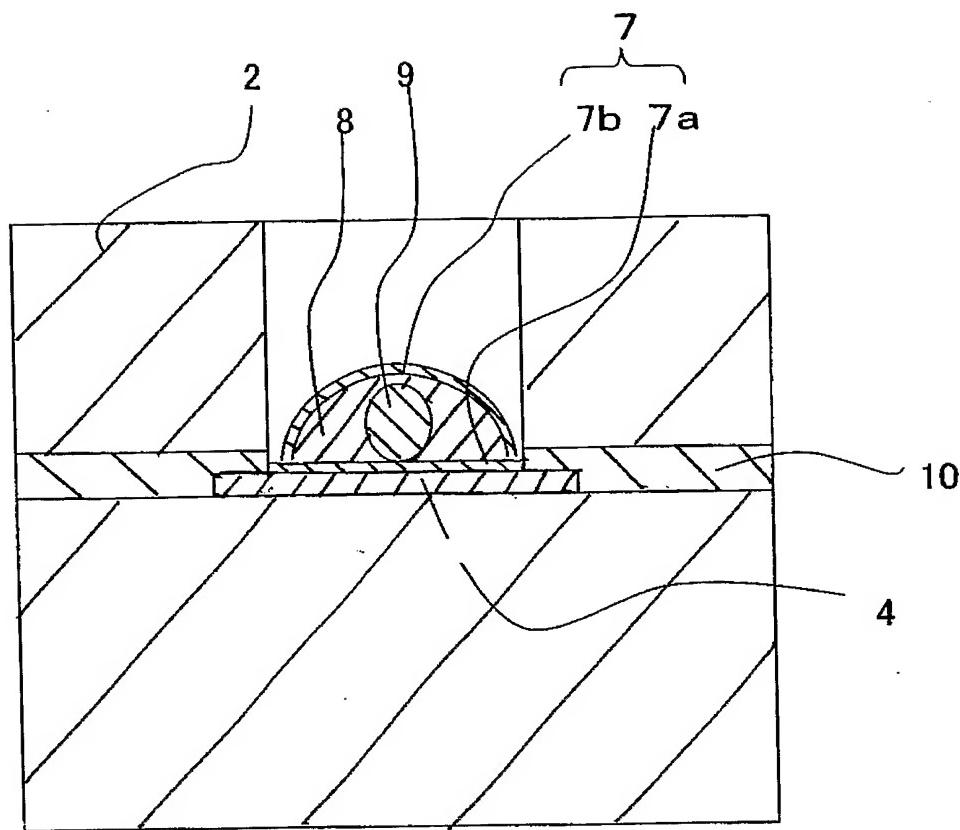
【図 2】



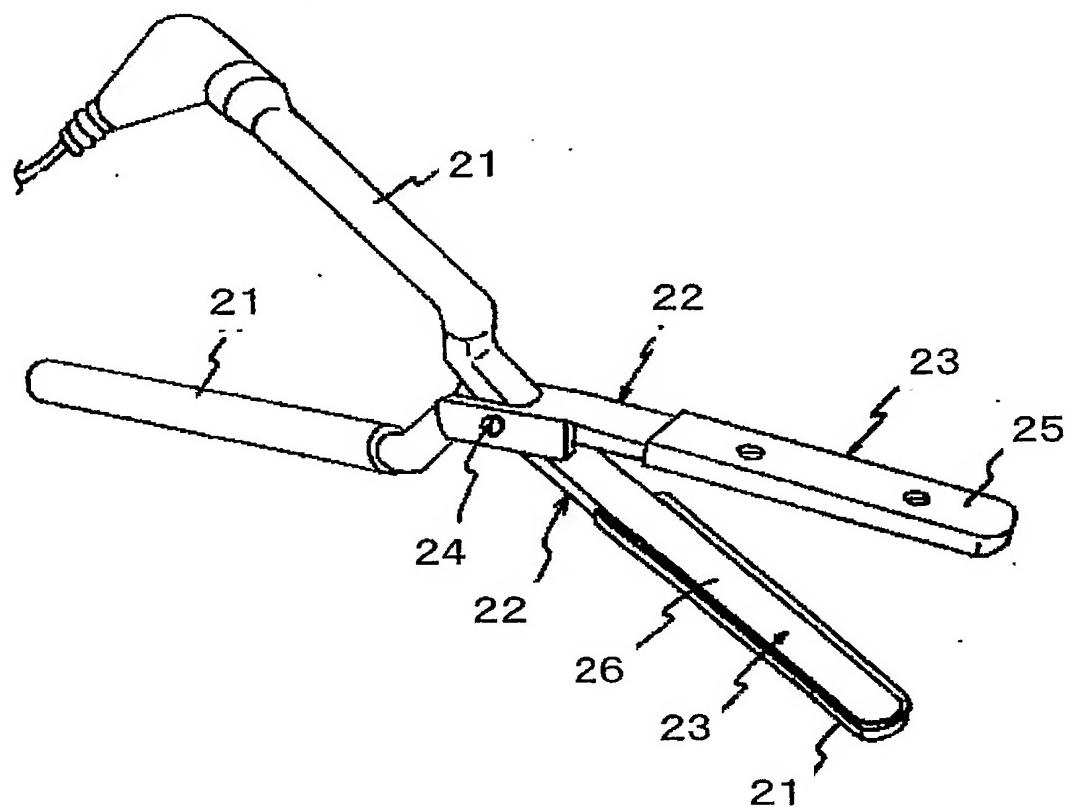
【図 3】



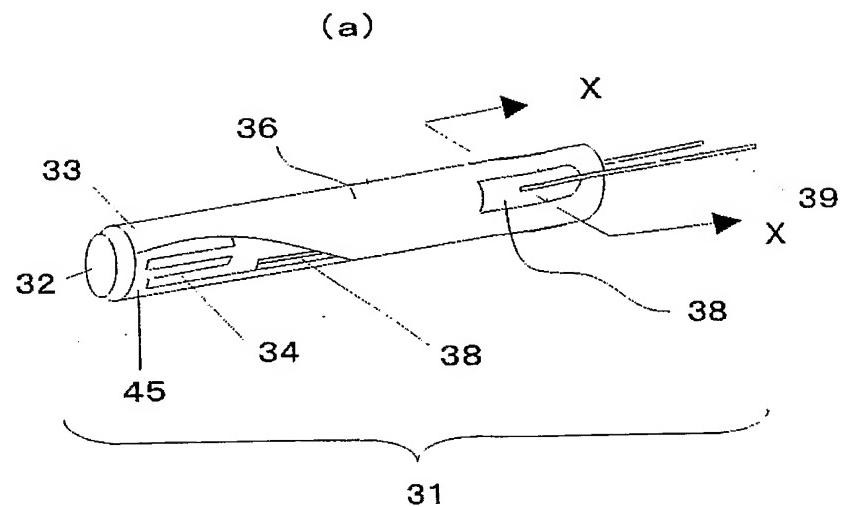
【図4】



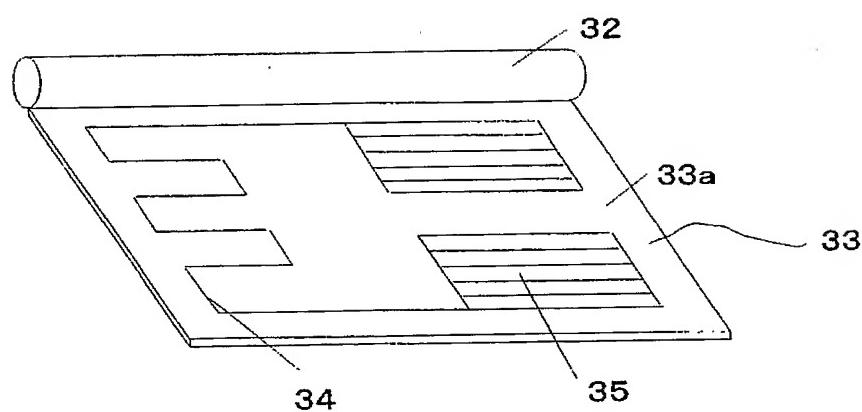
【図5】



【図6】



(b)



【書類名】要約書

【要約】

【課題】抵抗値を精密に制御すると同時に、耐久性良好なセラミックヒータを得る。

【解決手段】2つのセラミック基体の間に発熱抵抗体を形成し、所望の抵抗値に加工した
のち、封止部の熱膨張率と厚み、ボイド率を調整する。

【選択図】図 1

特願 2004-130940

出願人履歴情報

識別番号 [000006633]

1. 変更年月日 1998年 8月21日

[変更理由] 住所変更

住所 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
氏名 京セラ株式会社